

機械類個人資料蒐集、處理及利用之告知暨同意書

財團法人工業技術研究院(以下簡稱本院)為遵守個人資料保護法規定，於廠商提供個人資料予本院前，依法告知下列事項：

- 一、本院受委託辦理_____計畫，因執行計畫獲取您下列個人資料類別：申請人或聯絡人姓名、聯絡方式及證書內所記載產製廠場聯絡人姓名、聯絡方式以及前述產製廠場之客戶聯絡人姓名、聯絡方式(包括但不限於電話號碼、E-MAIL、營業地址)等，或其他得以直接或間接識別您個人之資料。
- 二、本院將依個人資料保護法及相關法令之規定下，依財團法人工業技術研究院隱私權保護政策，蒐集、處理及利用您的個人資料。
- 三、本院將於蒐集目的之存續期間合理利用您的個人資料。
- 四、除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，本院僅於中華民國領域內利用您的個人資料。
- 五、本院將於原蒐集之特定目的及其他公務機關請求行政協助之目的範圍內，合理利用您的個人資料。
- 六、您可依個人資料保護法第 3 條規定，就您的個人資料向本院行使之下列權利：
 - (一)查詢或請求閱覽。
 - (二)請求製給複製本。
 - (三)請求補充或更正。
 - (四)請求停止蒐集、處理及利用。
 - (五)請求刪除。您因行使上述權利而導致對您的權益產生減損時，本院不負相關賠償責任。另依個人資料保護法第 14 條規定，本院得酌收行政作業費用。
- 七、若您未提供正確之個人資料，本院將無法為您提供特定目的之相關業務。
- 八、本院因業務需要而委託其他機關處理您的個人資料時，本院將會善盡監督之責。
- 九、您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本院留存此同意書，供日後取出查驗。

個人資料之同意提供

- 一、本人已充分知悉貴院上述告知事項。
- 二、本人同意貴院蒐集、處理、利用本人之個人資料，以及其他公務機關請求行政協助目的之提供。

立同意書人：

中華民國 年 月 日